

10月31日(木)10:00-12:30	コース	10月31日(木)14:00-16:40	11月1日(金)12:50-15:05	11月1日(金)15:35-17:50
<b>KM-1 挨拶・基調講演 10:00-12:30</b> (受付・ウエルカムコーヒー 9:30 開始)	<b>【A】次世代自動車</b>	<b>A-1 自動運転/コネクテッドカー実現の最前線</b> 松浦正純(ルネサス)/山崎治(シャープFITオートモティブ)	<b>A-2 モビリティ進化を支える革新的キーデバイス</b> 松浦正純(ルネサス)/山崎治(シャープFITオートモティブ)	<b>A-3 次世代車載パワーデバイス</b> 石田昌宏(パナソニック)/佐藤高史(京都大学)
司会:中村 孝(大阪大学)  <b>◆来賓挨拶</b> 京都府副知事 山下 晃正 京都市長 門川 大作		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆自動運転の商業化                              株式会社ZMP 代表取締役社長 谷口 恒</li> <li>◆自動車データを活用したサービス                              本田技研工業(株) 経営企画統括部 ビジネス開発部                              ビジネス開発課 主任 福森 穂</li> <li>◆次世代自動車の世界市場展望～CASE戦略とイノベーションの動向～                              カノラマジヤパン(株) 代表取締役 宮尾 健</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆駐車支援/自動駐車システムのビューカメラ・イメージセンサの市場展望                              株式会社野野原研究所 自動車産業グループ マネージャー 主任 池山 智也</li> <li>◆車載向け距離画像センシング技術の進展                              パナソニック(株) イングストリアルソリューションズ社                              技術本部・センシングソリューション開発センター 部長 小田川 明弘</li> <li>◆CMOS Image Sensor Packaging Technology for Automotive Applications                              UTAC Group Chief Technology Officer Il Kwon Shim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆シリコンからSiCパワー半導体デバイスの最新技術動向                              筑波大学 数理物質系 物理工学領域 教授 岩室 憲幸</li> <li>◆車の電動化・知能化に向けた実証技術動向と課題                              日産自動車(株) 電子技術・システム技術開発本部/エキスパートリーダー 堀井 良和</li> <li>◆SiC MOSFETとIGBT使い分け                              インフィニオンテクノロジーズ(株) イングストリアルパワーコントロール事業本部                              マーケティング&amp;アプリケーションサポート部                              ビジネスデベロップメント&amp;マーケティングマネージャー 藤森 正然</li> </ul>
<b>◆基調講演「HPC(High Performance Computing)活用によるパナソニックのデジタルイノベーション」</b> パナソニック(株) テクノロジーイノベーション本部 HPCプロモーションセンター 所長 宮嶋 浩志  <b>◆基調講演「Society 5.0を支えるMRAMベースAIアプリケーションプロセッサの最前線」</b> 東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センター センター長 遠藤 哲郎  <b>◆基調講演「世界経済/政治の激動が続く中でニッポン電子デバイスはどう戦うのか」</b> ㈱産業タイムズ社 代表取締役社長 泉谷 渉	<b>【B】5G・AI・センシング</b>	<b>B-1 5Gの最前線</b> 加藤千晴(村田製作所)/岡田吉生(GF)	<b>B-2 AI向けデバイス</b> 岡田吉生(GF)/石田昌宏(パナソニック)	<b>B-3 次世代センシング</b> 泉谷渉(産業タイムズ社)/重松智志(NTTエレクトロニクス)/佐々木元(メガテックス)
11月1日(金)9:30-11:55  <b>KM-2 マーケティングセッション</b> 9:30-11:55 (受付 9:00 開始)	<b>【C】最先端半導体飛躍の時</b>	<b>C-1 世界をリードする日本の半導体材料技術</b> 酒井滋樹(日新イオン機器)/藤原健典(東レ)	<b>C-2 進化を続ける半導体プロセス・装置技術</b> 森義弘(SCREEN)/廣田良浩(東京エレクトロ)	<b>C-3 5G・AI・IoT時代を支える半導体デバイス・回路技術</b> 廣田良浩(東京エレクトロ)/三番士道彦(ローム)/山本浩之(マイクロモザイク)
司会:松下晋司(㈱産業タイムズ社)  <b>◆特別講演「市況減速に直面する半導体デバイスと製造装置、電子部品市場の現状と今後の展望」</b> ㈱産業タイムズ社 大阪支局 電子デバイス産業新聞 編集部 記者 中村 剛  <b>◆特別講演「IoT時代で変わる生活とエレクトロニクス産業～EV・IoT・AIが半導体産業を牽引する～」</b> IHS Markit TMT Japan Research Director 南川 明		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆EUVリソグラフィとマスク技術の動向                              大日本印刷(株) ファインオプトロニクス事業部 フェロー 林 直也</li> <li>◆レジスト材料とEUVリソグラフィ技術の最新動向                              富士フイルム(株) R&amp;D統括本部                              エレクトロニクスマテリアルズ研究所 マネージャー 藤森 亨</li> <li>◆シリコン基板をベースとした次世代パワーデバイスおよびイメージセンサ向け真空常温接合ウェーハの検討                              ㈱SUMCO 評価・基盤技術部 製品基盤技術課                              担当課長 古賀 祥泰</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆EUVパターニング技術と課題                              東京エレクトロ九州(株) 開発本部 プロセス技術部                              ブルーリーダー 村松 誠</li> <li>◆最先端半導体製造を支える最新洗浄技術                              ～先端ロジック/メモリからパワーデバイスまで～                              ㈱SCREENセレクトロニクスソリューションズ                              CGS製品統轄部 洗浄技術開発部 部長 高橋 弘明</li> <li>◆Specialty Markets &amp; More-than-Moore(MtM) Technologies                              Applied Materials INC, Group Vice President, General Manager, ICAPS Groups Sundar Ramamurthy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆Spin-Orbitronicsを応用した新型MRAMの紹介                              SPIN-ORBITRONICS TECHNOLOGIES(株)                              CEO &amp; CTO 興田 博明</li> <li>◆DRAM &amp; Emerging Memory Technology: Process and Materials                              Techinsight Inc. Technology Intelligence/Senior Technical Fellow                              Jeongdong Choo</li> <li>◆アナログ技術の粋を集めた革新的電源IC「Nano Series」の紹介                              ローム(株) LSI開発本部 回路技術開発部 先行電源技術開発課                              統括係長 山口 雄平</li> </ul>
<b>◆特別講演「フラットパネルディスプレイ業界:最終決戦～」</b> みずほ証券(株) エキイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ/シニアアナリスト 中根 康夫	<b>【D】特別セッション①</b>	<b>D-1 大学セッション(無料) ナノテクノロジープラットフォーム</b> 戸所義博(イーセップ)/向井雅昭(京都工芸繊維大学)	<b>D-2 パッケージング市場動向と最新技術動向(5G/μLED)</b> 藤原健典(東レ)/不破保博(ローム)	<b>D-3 最新FOパッケージング・材料・装置関連</b> 森川泰宏(ULVAC)/酒井滋樹(日新イオン機器)
<b>◆特別講演「フラットパネルディスプレイ業界:最終決戦～」</b> みずほ証券(株) エキイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ/シニアアナリスト 中根 康夫	<b>【E】特別セッション②</b>	<b>E-1 機器分解による電子部品市場の解析</b> 木村匡雄(ソニー)/中村孝(大阪大学)	<b>E-2 米中貿易競争下の中国半導体動向</b> 戸所義博(イーセップ)/神原弘之(ASTEM)	<b>E-3 先進半導体によるがん治療・診断革命</b> 松下晋司(産業タイムズ社)/中村孝(大阪大学)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆分解解析から見る注目のミリ波使用電子機器                              セミコンサルト 代表 上田 弘孝</li> <li>◆米Tesla社のModel Sを構成する電子デバイス                              展示アテンドも実施                              ㈱村田製作所 技術・事業開発本部 共通基盤技術センター                              企画管理課 シニアマネージャー 興膳 義明</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆中国半導体の方向性と展望                              ㈱産業タイムズ社 上海支局長 黒政 典善</li> <li>◆日米中韓の貿易摩擦の行方                              (一財)日中経済協会 専務理事                              東京工業大学 環境・社会工学学院 CBECプログラム 特任教授 杉田 定大</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆シリコン光電子増倍素子(SIPM)を用いたPET診断装置                              浜松ホトニクス(株) 中央研究所 第5研究室 副研究員 大村 知秀</li> <li>◆SiCパワーデバイスを用いた革新的BNCTがん治療装置の開発                              福島SiC応用技術研 代表取締役 CEO 古久保 雄二</li> <li>◆Metallo-balance 血液中の微量元素分析によりがんリスク・スクリーニングをおこなう方法                              ㈱レタテック 最高顧問 稲垣 精一</li> </ul>